

## 株主メモ

事業年度 每年8月1日から翌年7月31日まで

定期株主総会 10月

基準日 7月31日

配当金支払株主確定日

期末配当金 7月31日

中間配当金 1月31日

単元株式数 100株

上場市場 東京証券取引所市場第一部

公告方法 電子公告とし、当社ホームページ (<https://www.samco.co.jp/>) に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社

〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

電話 0120-094-777 (通話料無料)

※株式関係のお手続き用紙のご請求は、三菱UFJ信託銀行のホームページ (<https://www.tr.mufg.jp/daikou/>) でも承っております。

### (ご注意)

- 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取次ぎいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

### ホームページのご紹介

最新のトピックスをはじめ、財務情報や会社情報を掲載しております。製品・アプリケーションの紹介や広報誌「samco NOW」など、掲載内容を充実させております。当社をよりご理解いただくためにもぜひアクセスしてください。

<https://www.samco.co.jp/>



トップページ



**samco**  
サムコ 株式会社

証券コード 6387

**samco**

BUSINESS REPORT 2019

第40期 中間報告書  
2018.08.01 ▶ 2019.01.31



平成31年4月  
左：代表取締役社長兼COO 川邊 史  
右：代表取締役会長兼CEO 辻 理

進み、その中から本格生産への移行も進んでおります。

このような状況の下、前事業年度に引き続き、オプトエレクトロニクス分野の通信用レーザや、電子部品分野の高周波デバイス、パワーデバイス、MEMS、各種センサ等向け製造装置の受注活動、新製品の拡販に注力してまいりました。しかしながら、スマートフォン市場の需要低迷および米中貿易摩擦の影響による中国経済の減速により、当社の主要取引先である電子部品メーカーの設備投資意欲が一時的に低下したことにより、受注が伸び悩みました。

以上の結果、当第2四半期累計期間における業績は、売上高が2,772百万円（前年同期比35.0%増）、営業利益は281百万円（前年同期比263.8%増）、経常利益は262百万円（前年同期比262.0%増）、四半期純利益は185百万円（前年同期比279.2%増）となりました。

なお、配当につきましては、通期での実施を予定しておりますので、株主の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

当社第40期中間期の概況報告に先立ちまして、設立40周年のご挨拶を申しあげます。

当社は昭和54年（1979年）9月に京都市伏見区のガレージで設立し、以来約4,000台の装置を30カ国以上に納入してまいりました。これもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心より感謝申しあげます。コアテクノロジーである『薄膜技術』の強みを活かして、さらなる成長を続け、企業価値の最大化を図っていく所存でございます。今後とも一層のご支援を賜りますよう心からお願い申しあげます。

## 第40期中間期の事業環境と経営成績

当中間期、当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、半導体メモリーの需要拡大を背景にした積極的な設備投資は一旦収束しておりますが、当社の関わる化合物半導体および電子部品製造装置の販売マーケットにおいては、新たなモバイル機器や車載センサなどの電子部品分野、あるいはMEMS（Micro Electro Mechanical Systems=微小電気機械素子）といった先端分野での研究開発投資が幅広い企業で

進み、その中から本格生産への移行も進んでおります。

このような状況の下、前事業年度に引き続き、オプトエレクトロニクス分野の通信用レーザや、電子部品分野の高周波デバイス、パワーデバイス、MEMS、各種センサ等向け製造装置の受注活動、新製品の拡販に注力してまいりました。しかしながら、スマートフォン市場の需要低迷および米中貿易摩擦の影響による中国経済の減速により、当社の主要取引先である電子部品メーカーの設備投資意欲が一時的に低下したことにより、受注が伸び悩みました。

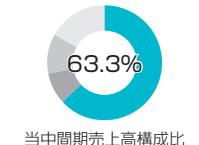
以上の結果、当第2四半期累計期間における業績は、売上高が2,772百万円（前年同期比35.0%増）、営業利益は281百万円（前年同期比263.8%増）、経常利益は262百万円（前年同期比262.0%増）、四半期純利益は185百万円（前年同期比279.2%増）となりました。

なお、配当につきましては、通期での実施を予定しておりますので、株主の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

## 品目別販売状況

### ■ エッチング装置

売上高	1,755百万円
前年同期比	45.6%増



国内のオプトエレクトロニクス分野の半導体レーザ（LD）向けの販売好調に加え、海外の電子部品分野のパワーデバイス向けの販売が伸び、売上高は1,755百万円となりました。

### ■ CVD装置

売上高	240百万円
前年同期比	27.3%減



国内、海外ともに電子部品分野の販売が増加した一方で、オプトエレクトロニクス分野の販売が振るわず、売上高は240百万円となりました。

### ■ 洗浄装置

売上高	311百万円
前年同期比	50.2%増



国内、海外ともにオプトエレクトロニクス分野と実装・表面処理分野の販売が伸び、売上高は311百万円となりました。

### ■ その他

売上高	464百万円
前年同期比	50.2%増



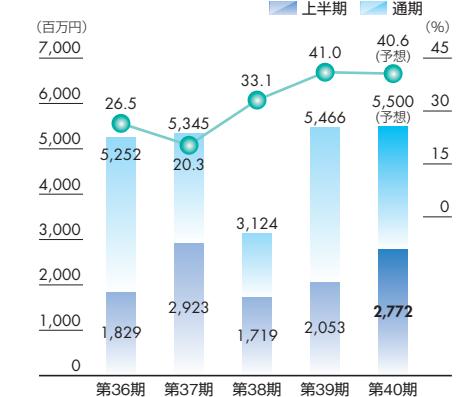
既存装置のメンテナンスや部品販売、装置の移設・改造作業などで、売上高は464百万円となりました。

### ■ 用途別売上高割合

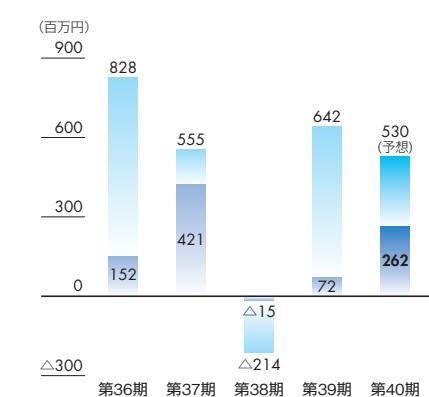
オプトエレクトロニクス分野	35.0%
電子部品分野	29.3%
シリコン分野	7.6%
実装・表面処理分野	6.2%
その他分野	5.1%
部品・メンテナンス	16.8%



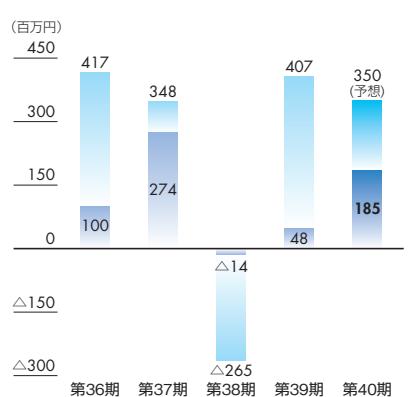
### ■ 売上高・海外輸出割合



### ■ 経常利益

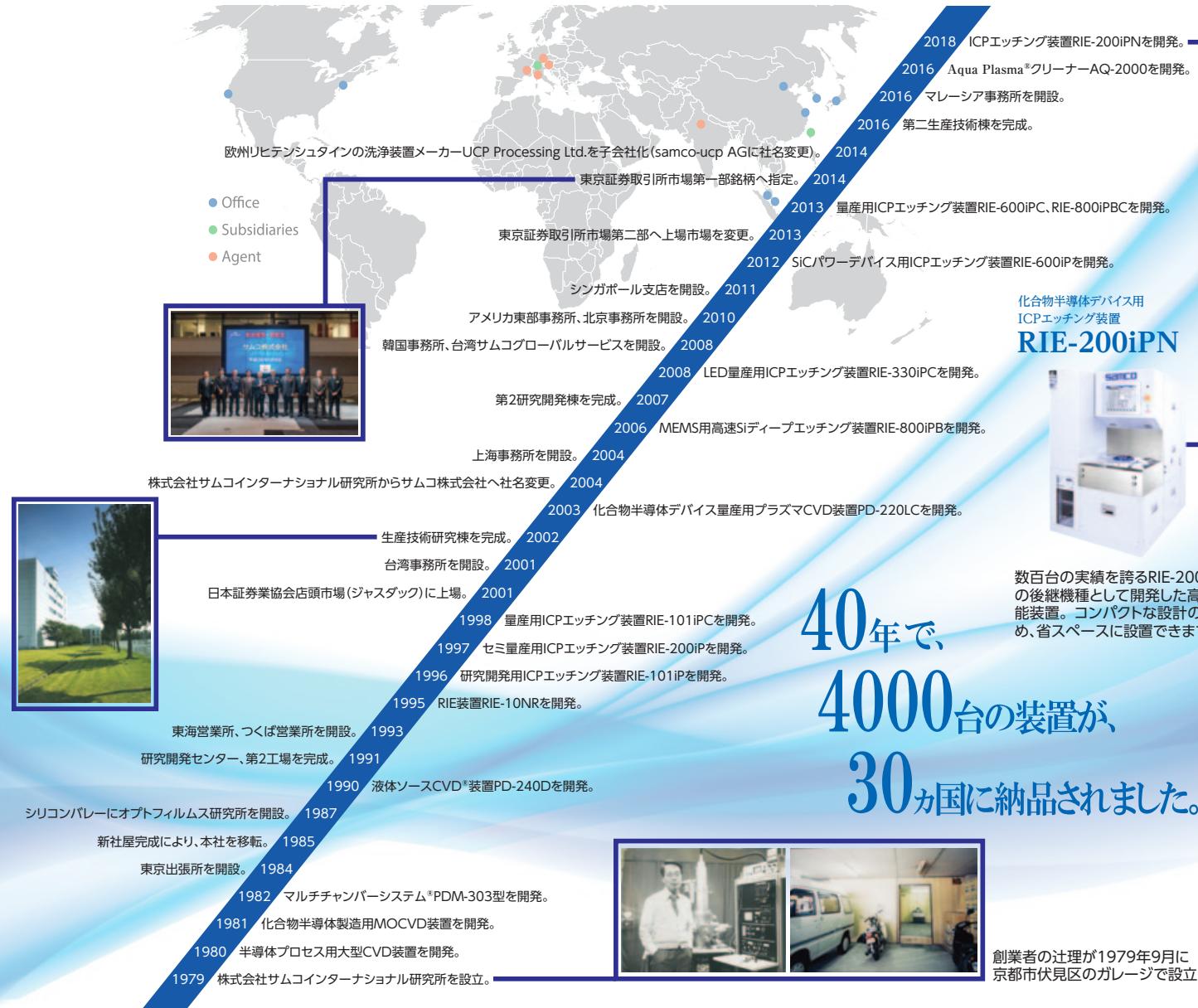


### ■ 中間(当期)純利益



## サムコの事業分野

当社は、快適な暮らしを支える半導体や電子部品を加工するための装置を製造・販売しております。設立以来、研究開発を積極的に進め、薄膜を微細加工するエッチング装置、薄膜を形成するCVD装置、基板表面をクリーニングする洗浄装置などの斬新な製品群を世界中に提供してまいりました。蓄積した技術、アプリケーションは多岐にわたり、その分野を拡大しております。



## オプトエレクトロニクス分野

## 電子部品分野



## ICPエッチング装置 プラズマCVD装置

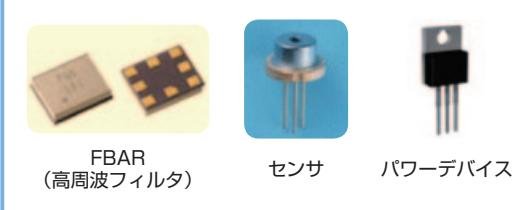


## Si深掘りエッティング装置 ALD装置

## 製造される デバイス



LED VCSEL LED  
(半導体レーザ) (面発光レーザ) (発光ダイオード)



FBAR  
高周波フィルタ) センサ パワーデバイス

最終製品



データセンター 3D顔認証システム ヘッドトラッピング  
バックランプ



## スマートフォン 車載用各種機器 発電システム

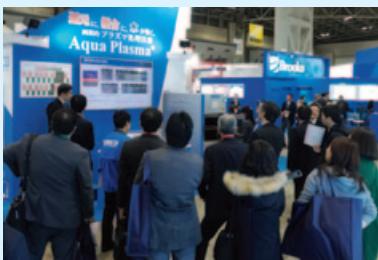
## ○次世代ICPエッティング装置『RIE-200iPN』の販売を開始

当社は、マイクロLEDやLD、GaNパワーデバイスなどの化合物半導体プロセスや難エッティング材料加工、シリコンナノプロセスでの研究開発からセミ量産に対応したICPエッティング装置の新製品『RIE-200iPN』の販売を開始しました。本装置は1997年に販売を開始し、数百台の納入実績を誇る『RIE-200iP』の後継機種として開発し、コンセプトである「汎用性」、「拡張性」、「コンパクト」をさらに発展させております。

すでに複数の大学から注文を得ており、次世代プロセスの研究開発用途での実績を積み上げ、将来的に試作、生産用途への展開を計画しております。



次世代ICPエッティング装置  
『RIE-200iPN』



SEMICON Japan 2018  
当社ブース

## ○SEMICON Japan 2018 報告

世界最大級のエレクトロニクス製造サプライチェーン総合展示会である『SEMICON Japan 2018』が12月12日から14日までの3日間、東京ビッグサイトで開催されました。

当社は、新製品の次世代ICPエッティング装置『RIE-200iPN』やプラズマCVD装置、ALD装置などを最新の技術データとともに紹介しました。また、Aqua Plasma®クリーナー『AQ-2000』の実機を展示し、銅の還元処理の実演やバイオテクノロジーへの応用が期待されるCOP接合の技術紹介を行い、多くの方々にご覧いただきました。

## ○サムコ科学技術振興財団 平成30年度 第2回研究助成金贈呈式および記念講演

2018年9月6日、京都リサーチパークにおいてサムコ科学技術振興財団 平成30年度 第2回研究助成金贈呈式が開催され、薄膜、表面および界面の分野の若手研究者6名にそれぞれ200万円、総額1,200万円が贈呈されました。

式典後には、光触媒研究の第一人者である東京理科大学 前学長で同大学光触媒国際研究センター長、東京大学特別栄誉教授の藤嶋昭先生（平成29年度文化勲章受章）の記念講演が行われました。

※研究助成対象者6名と研究課題につきましては当財団のホームページをご覧ください。  
<https://www.samco.co.jp/foundation/prize/>



研究助成金贈呈式

## ■会社概要

商 号 サムコ株式会社  
英 文 社 名 SAMCO INC.  
設 立 昭和54年（1979年）9月  
事 業 内 容 半導体等電子部品製造装置の製造、販売及び輸出入  
資 本 金 1,663,687,288円  
従 業 員 数 170名  
本 社 〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36番地  
TEL(075)621-7841 FAX(075)621-0936  
国 内 拠 点 本社（京都）、東日本営業部（東京）、  
東海支店（愛知）、つくば営業所（茨城）、  
福岡営業所（福岡）  
海 外 拠 点 米国（カリフォルニア・ニュージャージー）、  
台湾、シンガポール、中国（上海・北京）、韓国、  
マレーシア  
研 究 拠 点 本社研究開発センター（京都）、  
オプトフィルム研究所（米国）

## ■役員

代表取締役会長兼CEO 辻 理  
代表取締役社長兼COO 川邊 史  
取締役副社長 石川 詞念夫  
取締役常務執行役員 竹之内 聰一郎  
取締役執行役員 山下 晴彦  
社外取締役 村上 正紀  
小林 弘明  
常勤監査役 辻村 茂  
社外監査役 木村 隆之  
西尾 方宏  
執行役員 関 仲修  
久保川 泰彦  
ピーター・ウッド  
本山 慎一  
佐藤 清志

## ■株式の状況

発行可能株式総数 ..... 14,400,000株  
発行済株式の総数 ..... 8,042,881株  
株主数 ..... 7,561名

## ■大株主の状況

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
辻 理	1,005,707	12.5
サムコエンジニアリング㈱	920,282	11.4
財サムコ科学技術振興財団	800,000	9.9
辻 一美	201,465	2.5
サムコ従業員持株会	198,738	2.5
辻 猛	190,015	2.4
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)	153,200	1.9
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)	146,600	1.8
㈱三菱UFJ銀行	129,600	1.6
京都中央信用金庫	120,000	1.5

## ■所有者別株式分布状況

